

◆熱設計オンラインセミナー開催のお知らせ◆

『放熱材料・冷却デバイスの最新動向』

～車載機器からゲーム機、スマホ、基地局まで～

講師：国峯 尚樹 氏

(株)サーマルデザインラボ 代表取締役

日時：2021年2月5日（金）15：00～17：00

講師：国峯 尚樹 氏

(株)サーマルデザインラボ 代表取締役

演題：『放熱材料・冷却デバイスの最新動向』

～車載機器からゲーム機、スマホ、基地局まで～

主催：情報通信ネットワーク産業協会 装置実装委員会 実装技術 WG

参加：オンラインセミナー（一般公開・無料）

申込：受講希望者は1月29日までに下記ページよりお申し込み下さい。

<https://www.ciaj.or.jp/news/events/seminar>

オンラインセミナーのため、お申込みの方のメールアドレス宛に、当日のアクセス方法をご案内します。

<注意事項> ご提供いただきました個人情報は、CIAJ からの各種ご案内等に利用させていただきます場合がございますのであらかじめご了承下さい。

■講師紹介（敬称略）

国峯 尚樹（くにみね なおき）

1977年沖電気工業（株）入社

2007年（株）サーマルデザインラボ設立

主な著書

- ・熱設計完全制覇（日刊工業）
- ・熱設計完全入門（日刊工業）
- ・熱設計と数値シミュレーション（オーム社）
- ・トコトンやさしい熱設計の本（日刊工業）
- ・電子機器の熱流体解析入門第2版（日刊工業）
- ・トラブルをさけるための電子機器の熱対策設計第2版（日刊工業）

■講演概要

5G、IoT、CASE、AI、SiC等、様々なキーワードの下、機器の小型化・高性能化が進められています。車載機器やスマホ、基地局などファンレス密閉を要求される製品も多く、ギャップフィラーやPCM、ベーパーチャンバー、液体金属などの新しい材料、デバイスが活用されるようになってきました。こうした最新の冷却技術動向を紹介します。

【問い合わせ先】

CIAJ 共通技術部 宮守

E-mail: y-miyamori@ciaj.or.jp ※メールでの申込はできません

Tel: 03-5962-3452